

Mate 2010 第16回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」 シンポジウム 次世代製品へのブレークスルー技術 参加者募集

主催:(社) 溶接学会 マイクロ接合研究委員会
共催:(社) 機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計と熱制御に関する研究分科会, (社) 高温学会 微細加工研究情報委員会, (社) 日本塑性加工学会 接合・複合分科会, (社) 日本電気制御機器工業会, エレクトロニクス生産科学学会準備会, レーザ加工学会, 大阪大学 先端科学イノベーションセンター

協賛:映像情報メディア学会, エレクトロニクス実装学会, 応用物理学会, 化学工学会, 画像電子学会, 軽金属学会, 計測自動制御学会, 高温学会, 高分子学会, 資源・素材学会, システム制御情報学会, 情報処理学会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電気設備学会, 電子情報通信学会, 日本機械学会, 日本金属学会, 日本顕微鏡学会, 日本材料学会, 日本シミュレーション学会, 日本接着学会, 日本セラミックス協会, 日本塑性加工学会, 日本伝熱学会, 日本非破壊検査協会, 日本表面科学学会, 日本品質管理学会, 日本複合材料学会, 日本物理学会, 日本分析化学会, 日本溶接協会, 表面技術協会, プラスチック成形加工学会

開催趣旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

日時:平成22年2月2日(火) 8:50～17:50
平成22年2月3日(水) 9:00～17:30

会場:ワークピア横浜
横浜市中区山下町24-1

シンポジウム参加登録費(論文集代を含む)

○主催・共催団体登録会社 : 20,000円
○協賛学協会会員会社 : 30,000円
○論文口頭発表者 : 15,000円
○大学、国公立研究機関 : 10,000円
○学生 : 5,000円
○その他(一般) : 40,000円

シンポジウム参加申込方法

下記シンポジウム URL より平成22年1月22日(金)までに参加登録を行って下さい。

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2010.html>

参加費のお支払いは、銀行振込・クレジットカードのいずれかでお願ひ致します。

問合せ、申込先 Mate 2010 事務局 事務代行
合同会社フロンティア・アライアンス
ものづくりリエゾンオフィス事業部
TEL: 06-6878-5628, FAX: 06-6879-7568
E-Mail: mate@fa-mlo.com

参加申込締切日:平成22年1月22日(金)

振込先銀行:三井住友銀行 千里中央支店
口座番号:普通 0824444
口座名:合同会社フロンティア・アライアンス
ものづくりリエゾンオフィス

シンポジウム URL

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2010.html>

プログラム(セッション名と発表件数)

2月2日(火) 8:50～17:45 (17:45～懇親会)

●プレナリーセッション

「BEANS プロジェクトの特長と最新成果」

(技術研究組合 BEANS 研究所 安達 淳治)

「立体構造新機能集積回路(ドリームチップ)技術開発

—ドリームチッププロジェクト」

(技術研究組合 超先端電子技術開発機構 嘉田 守宏)

「太陽電池の研究開発動向

—太陽光発電未来技術研究開発プロジェクトを中心に」

(豊田工業大学 山口 真史)

2月2日（火） 8:50～17:45	2月3日（水） 9:00～17:30
[A-1] 品質・信頼性Ⅰ（5件） [A-2] 品質・信頼性Ⅱ（5件） [A-3] 疲労・熱疲労（5件） [B-1] ソルダペースト（5件） [B-2] むれ・溶解（5件） [B-3] 材料・界面反応（5件） [C-1] 基板・パッケージⅠ（講演1件+論文3件） [C-2] 基板・パッケージⅡ（4件）	[A-4] ナノマテリアル実装技術Ⅰ（講演1件+論文3件） [A-5] ナノマテリアル実装技術Ⅱ（講演1件+3件） [A-6] 鉛フリーはんだⅠ（5件） [A-7] 鉛フリーはんだⅡ（5件） [B-4] 樹脂実装・樹脂材料（講演1件+論文3件） [B-5] 3D実装（講演1件+論文4件） [B-6] フリップチップ（4件） [B-7] パワーモジュール（講演1件+論文3件） [C-4] 低音接合・常温接合（講演1件+論文3件） [C-5] レーザ微細加工（講演1件+4件） [C-6] MEMS（4件） （一般論文発表合計86件）